

SUR-TIN

Chem. Verzinnung

Arbeitsanleitung

Ansatz

Die folgende Vorschrift zum Ansatz von SUR-TIN muss aus Sicherheitsgründen in Ablauf und Reihenfolge streng befolgt werden.

Füllen Sie bitte zunächst 2 l Wasser, Temperatur ca. 50 °C in ein sauberes, temperaturbeständiges Gefäß mit einem Fassungsvermögen von min. 3 Litern.

Fügen Sie SUR-TIN Teil I hinzu und rühren Sie das Gemisch um. Vorsicht, ätzend: Augen schützen! Spritzer auf Haut und Kleidung vermeiden! Immer SUR-TIN Teil I zum Wasser geben, nie umgekehrt verfahren. Das Produkt enthält Schwefelsäure.

Fügen Sie nun SUR-TIN, Teil II hinzu. und rühren Sie die Flüssigkeit so lange um, bis Teil II vollständig gelöst ist.

Unter dauerndem Rühren mischen Sie nun bitte Teil III hinzu. Es entsteht eine fast klare, gebrauchsfertige Lösung. Die pulverförmigen Bestandteile II und III von SUR-TIN sind gesundheitsschädlich. Einatmen und Verschlucken vermeiden!

Aufbewahrung

Die gebrauchsfertige Lösung ist wiederverwendbar und mehrere Monate haltbar. Sie soll in einem deutlich gekennzeichneten, verschlossenen Gefäß bei mind. 20 °C und im Dunkeln aufbewahrt werden.

Anwendung

Mit der Zeit bildet sich am Boden des Vorratsgefäßes ein weißer Niederschlag. Die Lösung muss daher vor Gebrauch kräftig geschüttelt oder aufgerührt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 20 und ca. 40 °C liegen.

Vor dem Verzinnen muss der Fotolack gründlich entfernt werden. Als praktikabel hat sich das nochmalige ganzflächige Belichten und Entwickeln der Platine erwiesen. Natürlich kann die Reinigung auch mit Lösungsmitteln (Alkohol, Aceton etc.) erfolgen. Achtung: Auch geringe Rückstände von Fotolack behindern den Vorgang!

Vor dem Verzinnen ist eine gründliche Spülung der Platine unter fließendem Wasser unerlässlich. Übrigens machen sich auch Fingerabdrücke auf dem Kupfer störend bemerkbar!

Lassen Sie die Platine nun bitte in die Schale mit Verzinnungslösung gleiten. Die Zinnabscheidung auf dem Kupfer setzt sofort ein und ist nach etwa 2-3 Minuten abgeschlossen. Die chemische Reaktion ist selbst begrenzend, die maximal erzielbare Schichtdicke beträgt etwa 5µm.

Nach der Verzinnung wird die Platine nochmals unter kräftigem, heißem Wasserstrahl gründlich gespült und dann mit saugfähigem Papier kräftig abgerieben.

Die Lötbarkeit ist auf der frischen Zinnschicht am besten. Besonders bei feuchter oder durch Chemikaliendämpfe belasteter Umgebungsluft kann es nach wenigen Tagen passieren, dass die Zinnschicht wieder anläuft. In diesem Fall kann die Platine einfach noch einmal in die Verzinnungslösung gelegt werden.

Die vorliegende Anleitung basiert auf umfangreichen Laborversuchen. Sie soll Ihnen einen problemlosen Umgang mit SUR-TIN ermöglichen. Für Schäden durch Nichtbeachtung oder für andere Folgen bei der Anwendung können wir jedoch naturgemäß nicht haften.

Zu den in SUR-TIN verwendeten Chemikalien halten wir Sicherheitsdatenblätter für Sie bereit.

(C) 1989-2009 Bungard Elektronik